

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

- 一、信評機構標普(S&P)、惠譽(Fitch)、穆迪(Moody's)公告調降英特爾公司(Intel Corporation)的發行人及債券信用評等，調整結果及本行相關商品如下：

發行人名稱	信評機構	信用評等	
		變更前	變更後
英特爾公司	標普	A+	A
	惠譽	A+	A-
	穆迪	A1	A2

債券代號	債券名稱
B512、B721	英特爾公司2025年美元可贖回債券
B510、B717	英特爾公司2027年美元可贖回債券
B513、B722	英特爾公司2030年美元可贖回債券
B514、B723	英特爾公司2032年美元可贖回債券
B511、B720	英特爾公司2047年美元可贖回債券

- 二、信評調整主要因素：

標普此次降評主要考量英特爾在2022年財報表現疲弱且短期無法改善經營狀況，疊加同業競爭加劇，威脅其市場主導地位，故下調其信用評級自A+至A，展望維持負向。由於個人電腦(PC)市場需求持續疲弱、客戶端和伺服器端市場的庫存調整，以及公司特定的執行問題，使其去年第四季財報及今年第一季財務指引等皆遠低於標普預期，且預計PC市場疲軟問題將延續至今年第一季，公司在客戶端運算、數據中心與人工智慧，以及網路與邊緣業務的營運業績都將陷入疲弱，預估2023年的自由現金流將持續流出為負的70~80億美元，財務槓桿弱化至2.0~2.5倍。另外鑒於英特爾先前技術問題導致產品延宕生產，增加研發成本事件，競爭對手得以逐漸增加市場份額，進而威脅其市場的主導權。

惠譽認為英特爾的客戶需求減少，公司的財務指標疲軟，且同業競爭加劇以致其市場份額下降，故下調其信用評級自A+至A-，展望為負向。英特爾在PC和資料中心(DC)領域面臨對手AMD的激烈競爭，代工領域目前也遜於台積電，預期在疫情後的需求持續降溫導致半導體業庫存過剩將造成營收和獲利在2023大幅下滑，在此情況下，英特爾尋求重新獲得技術領先地位並建立其代工服務業務的優勢難度高，密集的投資將導致其中期內自由金流為負，即便有政府獎勵政策也不足以支撐其大量的現金需求，將需要增加債務融資，進而對其信用指標構成壓力，且英特爾將在削減成本的同時，在未來3~5年內著手投資以超越競爭對手，執行風險大。

穆迪評估英特爾財務指標疲弱且產品市佔下降，同時轉型計畫的執行風險高，故下調其信用評級自A1至A2，展望為負向。公司在PC與伺服器市場的需求疲弱使其營收顯著銳減，2022年財務槓桿由1.3倍增加至3.0倍，預期未來12~18個月將可能超過4倍，同業競爭的加劇也致使公司積極加速伺服器產品的推出及擴張晶圓代工業務，以鞏固市場地位，故穆迪預計英特爾的資本支出將佔收入的35%，即使同時進行成本節約計劃仍難以抵禦營運下滑的態勢，預計EBITDA至少於下半年才有望復甦，方能緩解財務槓桿。

三、未來展望:

標普給予負向的展望，認為其財務槓桿預計將持續2.0倍左右，因2024年持續營運資金需求以及支付股息，使債務水準保持高位，若業務復甦因技術發展延遲、市佔減少、競爭地位減弱，或是自由現金流持續疲軟、因獲利能力衰退或財務政策轉趨積極使槓桿保持在2.0倍以上，將考慮再次降評；若技術發展順利使獲利增強、槓改低於2.0倍，則可能將展望調升至穩定。

惠譽給予負向的展望，若競爭地位下滑或產品推出再次受阻、技術研發再次失敗使2025年後的自由現金流量仍為負值、槓桿率維持2.0倍以上，則可能再度降評；若DC的市佔重回80%以上，在激烈競爭中展現技術領先、PC/DC領域之外的多元營收顯著成長，可預期的槓桿率降至1.5倍，則可能調升其評等。

穆迪給予負向的展望，因其預期英特爾未來1~2年的財務槓桿超過4.0倍的可能性高，若其產品的推出延遲、執行上遭遇挑戰或同業競爭壓力致使其2023年市佔率或獲利能力比預期下滑嚴重，或至2024年都無法產生穩定且強勁的EBITDA，以及高於預期的現金流出，皆可能再次將評；若英特爾轉型計劃能成功為其帶來獲利並使其重回PC及伺服器市場主導地位，預期其財務槓桿將降至2.0倍以下，並有強勁的流動性，則可能調升其評等。

原文下載: [標普官方新聞稿](#)、[惠譽官方新聞稿](#)、[穆迪官方新聞稿](#)